

1. Модуль (1) чіп-носіє, який містить носіє (3), у якому виконано наскрізну виїмку (4), напівпровідниковий чіп (2), розміщений у виїмці (4), розміщену на одному боці носія (3) щонайменше одну захисну пластинку (5), яка накриває напівпровідниковий чіп (2) і частину носія (3) і крайовими зонами (6) оберненої до чіпа (2) поверхні прикріплена до цієї частини носія (3), причому напівпровідниковий чіп (2) закріплений на захисній пластинці (5), який **відрізняється** тим, що носіє виконаний із паперу чи пластмасової плівки і додатково до вказаної першої захисної пластинки (5) він містить другу захисну пластинку, яка на протилежному першій захисній пластинці (5) боці носія (3) накриває напівпровідниковий чіп (2) і частину носія, і крайовими зонами (6) своєї поверхні, оберненої до напівпровідникового чіпа (2), прикріплена до цієї частини носія (3).
2. Модуль чіп-носіє за п. 1, який **відрізняється** тим, що щонайменше одна захисна пластинка (5) і/або напівпровідниковий чіп (2) прикріплені клеєм.
3. Модуль чіп-носіє за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що щонайменше одна захисна пластинка (5) виготовлена із паперу чи пластмасової плівки.
4. Модуль чіп-носіє за будь-яким із пп. 1 - 3, який **відрізняється** тим, що щонайменше одна захисна пластинка (5) настільки глибоко запресована у носіє (3), що утворюється в основному рівна поверхня модуля.
5. Модуль чіп-носіє за будь-яким із пп. 1-4, який **відрізняється** тим, що щонайменше одна захисна пластинка (5) оснащена електропровідним шаром у формі котушки, виконаної з можливістю утворення індуктивного зв'язку з котушкою, розміщеною на напівпровідниковому чіпі (2).
6. Модуль чіп-носіє за п. 5, який **відрізняється** тим, що електропровідний шар виконаний у формі кільцеподібної доріжки (7), яка розміщена поза зоною захисної пластинки (5), що накриває напівпровідниковий чіп (2), і яка повністю охоплює напівпровідниковий чіп (2) по колу до розриву (8).
7. Модуль чіп-носіє за будь-яким із пп. 1-4, який **відрізняється** тим, що щонайменше одна захисна пластинка (5) оснащена електропровідним шаром для захисту від електричних, електростатичних чи електромагнітних впливів.
8. Модуль чіп-носіє за будь-яким із пп. 1-7, який **відрізняється** тим, що у носії навколо виїмки (4) і між захисними пластинками (5) виконано мікроканали чи наскрізні отвори (9), заповнені клеєм.
9. Модуль чіп-носіє за будь-яким із пп. 1-8, який **відрізняється** тим, що клей є електропровідним і завдяки цьому утворене електричне з'єднання між розміщеними одна навпроти другої електропровідними зонами захисних пластинок (5).